

株主メモ	
事業年度	4月1日から翌年3月31日
配当金受領 株主確定日	期末配当金:3月31日 中間配当金:9月30日
単元株式数	100株
定時株主総会	毎年6月
公告方法	電子公告 (https://www.fujimiinc.co.jp) ただし、事故その他やむを得ない事情によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することといたします。
株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵便物送付先 及び照会先	〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711 (通話無料)

株式会社フジミインコーポレーテッド

お問い合わせ先：経営企画部経営企画課
TEL：052-503-8181 (代表)
URL：https://www.fujimiinc.co.jp

Copyright (C) 2023 Fujimi Incorporated. All rights reserved.



この印刷物は、適切に管理された森林で生産された木材を使った環境配慮型のFSC®認証紙と、植物油を使用し、VOCの排出を抑えた環境対応型リサイクルインキ「ベジタブルインキ」を使用しております。

各種手続きのお申出先

- 支払期間経過後の配当金のお支払いについては、株主名簿管理人にお申出ください。
- 住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等

証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。
証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関である日本証券代行株式会社へお申出ください。

ご注意

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、日本証券代行が口座管理機関となっておりますので、下記特別口座の口座管理人に、お問い合わせください。

特別口座 管理機関

日本証券代行株式会社

連絡先

〒168-8620
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
日本証券代行株式会社 代理人部
電話 0120-707-843 (通話無料)

株式会社フジミインコーポレーテッド 株主通信

FUJIMI TODAY vol.57

2023.4.1 ~ 2023.9.30

2023年12月発行

特集

新中長期経営計画の概要とQ&A

技術を磨き、心をつなぐ

FUJIMI

証券コード 5384



お客様目線の実践

パウダー＆サーフェスカンパニーへの進化

「働きがい」と「働きやすさ」の醸成

当事者意識とやり抜く力の確立

革新への挑戦



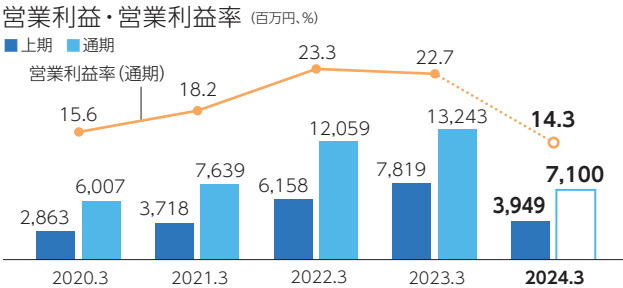
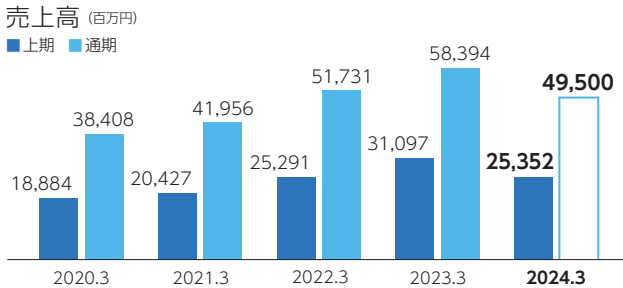
技術を磨き、 心をつなぐ

私たちの「磨く技術」は半導体をはじめとした
さまざまな産業で活かされています。
フジミはお客様にあらゆる製品を
磨いていただくことで、
人々が快適に暮らせる未来の創造に
貢献します。

代表取締役社長

関 敬史

連結決算ハイライト ※2024年3月期通期は予想値



株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

上期を振り返って

当社グループを取り巻く環境は、世界的な景気後退と地政学リスクへの懸念が一層高まり、世界経済の不透明感は強まりました。資源・エネルギー価格は再び上昇に転じ、鈍化傾向にあったインフレ率に下げ止まりが見られました。また、中国の景気は不動産市場の悪化を契機に弱含みが続いており、世界経済の下振れリスクが高まっております。

世界半導体市場は、パソコン、スマートフォン及びサーバー市場の低迷に伴い、2022年秋以降の半導体デバイスの生産及び在庫の調整が想定以上に長引いており、シリコンウェハールにおいても減速感が強まっております。

こうした状況下、半導体向け製品の販売が減少したことに加え、原材料価格などの上昇の影響を受け、当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高25,352百万円(前年同期比18.5%減)、営業利益3,949百万円(前年同期比49.5%減)、経常利益4,430百万円(前年同期比46.6%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益3,377百万円(前年同期比45.1%減)となりました。

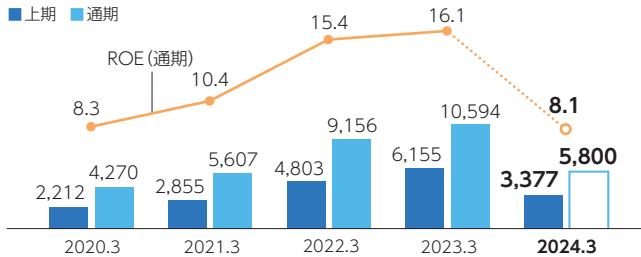
2024年3月期の見通しについて

通期の連結業績につきましては、半導体市場の調整はしばらく継続し、本格的な回復には今なお時間を要すると見られることから、売上高49,500百万円(前期比15.2%減)、営業利益7,100百万円(前期比46.4%減)、経常利益7,650百万円(前期比43.7%減)、親会社株主に帰属する当期純利益5,800百万円(前期比45.3%減)に見直しました。一方で、配当につきましては期初予想からの変更はなく、中間配当は1株36.67円とし、年間配当は1株73.34円を予定しております。

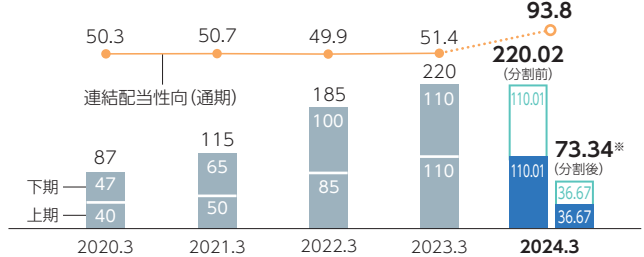
半導体市場は現在調整局面ですが、中長期的には旺盛な需要が見込まれ、当社のお客様であるシリコンウェハールメーカー及び半導体デバイスメーカーの多くは積極的に大規模な設備投資・計画を公表しております。当社においても将来的なさらなる需要増加を見込み、研究開発や設備投資の手を緩めずに推進するとともに、誠実に、真摯にお客様の目線に立って、製品・サービスを提供してまいります。重ねてサステナブルな経営の根幹を成す人材投資やESGに関わる取り組みも積極的に推し進めてまいります。

皆様のご厚情に感謝するとともに、これまでと変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益・ROE (百万円、%)



配当金・連結配当性向 (円、%)



※当社は、2023年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割しており、2024年3月期(予想)の配当金については、当該株式分割を考慮して記載しております。

新中長期経営計画の概要とQ&A

前号に引き続き、新中長期経営計画の特集です。
株式分割を行ったこともあり、新たに当社株式を取得していただいた方もおられますので、今号では、改めて2023年5月に公表した「中長期経営計画2023」の概要をご紹介します、前号の株主様アンケートやIRフェア(展示会)でいただきました当計画に関するご質問にお答えします。

中長期経営計画2023の概要

世界経済の不透明感や米中間の緊張、環境問題への対応など、当社事業を取り巻く環境は非常に不透明な状況ではありますが、当計画期間中はデータセンターや自動車、産業機械向けを中心に半導体市場の伸長を見込み、定量目標と目指す姿を設定しました。

目標項目	2023年3月期 (実績)	2024年3月期 (期初予想)	2026年3月期 (計画)	2029年3月期 (計画)
連結売上高	583億円	585億円	770億円	950億円
新規事業売上構成比	2.0%	3%	15%	20%
非半導体売上構成比	14.0%	15%	20%	25%
非研磨分野売上構成比	4.4%	5%	8%	10%
営業利益率	22.7%	21.4%	20%	20%
EBITDAマージン*	25.6%	25.0%	26%	27%
ROE	16.1%	13.9%	15%	15%
配当性向	51.4%	56.7%	55%	55%

2030年に目指す姿

収益性確保を図りつつ、
連結売上高1,000億円を目指す

還元の変遷と新還元方針

- 株主還元を一段強化
 - 変更後 連結配当性向 55%以上を目標
 - 変更前 連結配当性向 50%以上を目標
- 安定配当の継続にも留意し、DOEを配当の指標に加えることも検討する

※EBITDAマージン:売上高に占めるEBITDA(営業利益+減価償却費)の割合。

●目指す姿と取り組みの方向性:区分別

区 分	目指す姿	取り組みの方向性
半 導 体	CMP	世界トップのFEOL*スラリーメーカー 先端のお客様の期待に応える品質・技術の確立と日本・米国・台湾3拠点体制による強みの極大化
	シリコン	シリコンウェハー向け研磨材のリーディングカンパニー 独自技術の確立(原料設計、配合・精製技術)によるお客様ごとの研磨加工プロセスのソリューション提供
	実装基板	実装基板向け材料分野での事業機会獲得 先端パッケージ技術に対応した顧客密着型製品開発の推進
	SiC	SiCパワー半導体向け研磨材の主要サプライヤー コア技術を基盤とした新技術の確立と高効率性を有する製品投入によるマーケットシェアの拡大
	溶射	溶射材市場でのシェア拡大 複合技術を活用したソリューション提供によるお客様価値の創造 ●半導体:先端半導体製造装置向け製品の開発/パートナー地位の確立 ●非半導体:事業の柱となる未参入・新規の有望案件の発掘と獲得
非 半 導 体	ディスク	市場シェア奪回によるメインプレイヤーへの返り咲き 開発能力の強化とお客様への技術サポート体制の充実による製品競争力の強化
	研磨ソリューション	研磨ソリューション領域での新規事業の創出 自動車用研磨コンパウンドをはじめ、お客様のウォンツに応える先進の研磨ソリューションの提供
	先端技術・機能材料	パウダー領域での新規事業の創出 独自の技術マーケティング力とパウダー技術を駆使した機能性材料(セラミックスパウダー、セラミックス複合材、新規パウダーなど)の開発継続・事業化

●FEOL… Front End of Lineの略。トランジスタ・キャパシタ等形成工程。

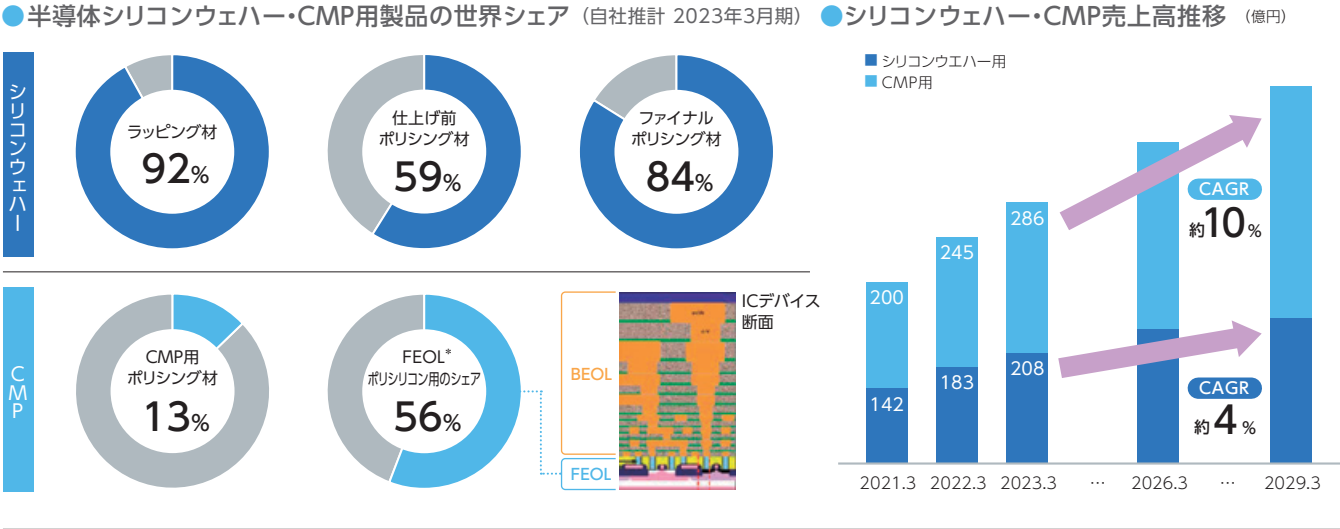
半導体関連の戦略・状況について

株主様のご質問

分野別のシェアを教えてください。

当社は1950年に日本初となる精密人造研磨材（以下、研磨材）を製造して以来、さまざまな用途に、多くの製品を提供してまいりました。なかでも、半導体シリコンウェハーの製造工程で使用されるラッピング材*、ファイナルポリシング材*はいずれも他を圧倒する高い世界シェアを保持しております。また、仕上げ前のポリシング材では、2017年時点の世界シェアは約30%でしたが、半導体の配線間隔の微細化に伴いお客様の要求する品質レベルが上がったため当社製品の性能が評価され、2023年には約60%までシェアを伸ばしております。高度化するお客様の要求に対応するため、引き続き高い技術力で独自性の強い新製品を提供し「最も信頼されるパートナー」を目指してまいります。

半導体デバイスの製造工程で 사용되는CMP（化学的機械研磨）用製品では、現在の世界シェアは約13%と2位グループの1社に位置しております。一方で、半導体の性能を左右するトランジスタ素子形成工程（FEOL）のポリシリコン向けに限れば、当社は世界シェアの過半を占めております。半導体デバイスは高性能化、高密度化、高集積化に伴い研磨対象となる膜種とCMPが適用される工程は増加傾向にあります。日本・米国・台湾での製造・研究開発・品質管理を強化し、お客様との密接な関係構築とロードマップに沿った新製品の開発を継続して推進してまいります。



●ラッピング材…シリコン基板等を粗磨きするための粉末研磨材。●ファイナルポリシング材…ファイナルポリシング工程で 사용되는鏡面仕上げ研磨スラリー（液体研磨材）。●FEOL…Front End of Lineの略。トランジスタ・キャパシタ等形成工程。

株主様のご質問

市場の展望を教えてください。

AI進展、自動運転・EVの影響など

足下の世界半導体市場は、パソコンやスマートフォン、サーバーなどの需要低迷を受け、2022年秋から生産及び在庫調整が継続しており、世界半導体市場統計（WSTS）によれば、2023年は前年比10.3%減（2023年6月公表）と2桁のマイナス成長が見込まれています。しかしながら長期的には、市場規模は足下の約5,000億ドルから、2030年には1兆ドルを超える規模に拡大すると予測されています。

半導体はAI（人工知能）や自動運転など世界中が注目する最新技術に欠かせないものとなっており、その重要性と期待される市場の成長性から、世界各国が半導体の国産化を狙い、国家主導の投資によって半導体の確保及び生産シェアの拡大を図っています。

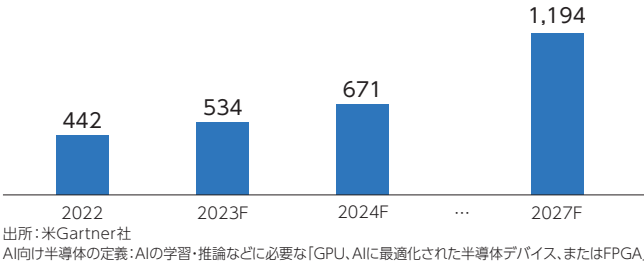
また、脱炭素社会の実現に向け電気自動車（EV）や再生可能エネルギーへの関心が高まる中で、SiC基板を用いたパワー半導体の市場が急成長しており、その市場規模は2026年には2022年の3倍以上となる50億ドルを超えるとの予測も出ています。

当社は、これらの市場拡大を見据え、グローバルな製品供給体制の拡充を推し進めるとともに、半導体プロセスの高度化に応える業界トップ水準の研究開発・品質保証力の維持と向上に取り組んでまいります。

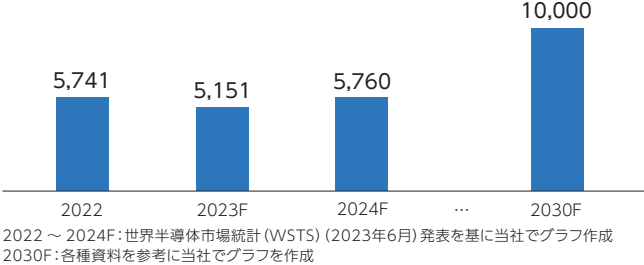
●当計画期間中の当社設備投資（一部着手済）

日本（岐阜県）	●新工場建設（CMP・シリコン用スラリー） ●既存工場増設による増加（//） ●老朽施設の改修とともに事業構造転換を推進
米国（オレゴン州）	●新工場棟建設（CMP用スラリー） 米国内の米国・台湾半導体デバイスメーカーの最先端半導体製造能力増強に対応 ●SiC基板向け研磨材の量産着手
台湾（苗栗県）	●新生産ライン導入（CMP用スラリー） 台湾半導体デバイスメーカーの次世代最先端、最先端半導体製造能力増強に対応 米国向け一部製品をカバー
マレーシア（ケダ州）	●SiC基板向け研磨材の量産着手

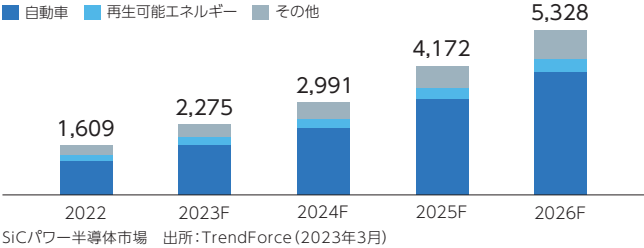
●AI向け半導体の世界市場予測（年次 実績/予測）（億USDドル）



●世界半導体市場動向（年次 実績/予測）（億USDドル）



●SiCパワー半導体市場動向（年次 実績/予測）（百万USDドル）



非半導体関連の戦略・状況について

株主様のご質問

非半導体関連の成長戦略における可能性など、もう少し詳しく情報開示してください。

当社の半導体関連の売上は全体の8割以上を占めており、半導体関連への依存が大きくなっております。半導体は好不況の波が大きいことから、当社としては安定的かつ持続的な成長を遂げるため、特定の市場や用途に偏ることがない事業構造が必要と考え、事業領域を研磨材からパウダー（粉）とサーフェス（表面）に広げ、業態の進化を目指しております。

非半導体関連の事業には、ディスク・溶射材・研磨ソリューション・機能材料の事業があります。その中でパウダー（粉）とサーフェス（表面）両方に関連する溶射材事業は、新規事業開拓を目的に、1998年溶射材の開発に着手し、2003年より本格的に事業を開始しました。安定した利益が出るまでしばらく苦戦が続きましたが、研究開発や迅速な営業活動、学会への発表など、さまざまな取り組みを経て、現在は20億円近くの売上にまで成長しております。

新規事業の開拓や育成、非半導体・非研磨関連の新規用途開拓や研究開発には時間を要しますが、辛抱強く取り組むとともに、引き続きM&Aも積極的に検討してまいります。取り組み例を下記にご紹介します。

●非半導体関連のパウダー（粉）分野

高い放熱性と流動性を備えたセラミックパウダー	用途:放熱材料
板状の形状で高白色なリン酸チタン粒子	用途:化粧品材料など
金属3Dプリンター用超硬合金粉末	用途:金型・工具

PICK UP 金属3Dプリンター用超硬合金粉末

「知の拠点あいち重点研究プロジェクトII期(2016～2018年)」の研究テーマに採択されて以降、当社は金属3Dプリンターに適した超硬合金粉末と積層造形技術の研究開発を継続しています。2022年には開発した超硬合金粉末で造形された金型を用いて連続成形試験を実施した結果、製品製造への適用が可能であることが確認されました。

現在はIV期(2022～2024年)に突入し、2025年以降の本格的な製品化・実用化に向けて、超硬合金粉末を用いた金型の造形精度と硬度向上を図っています。

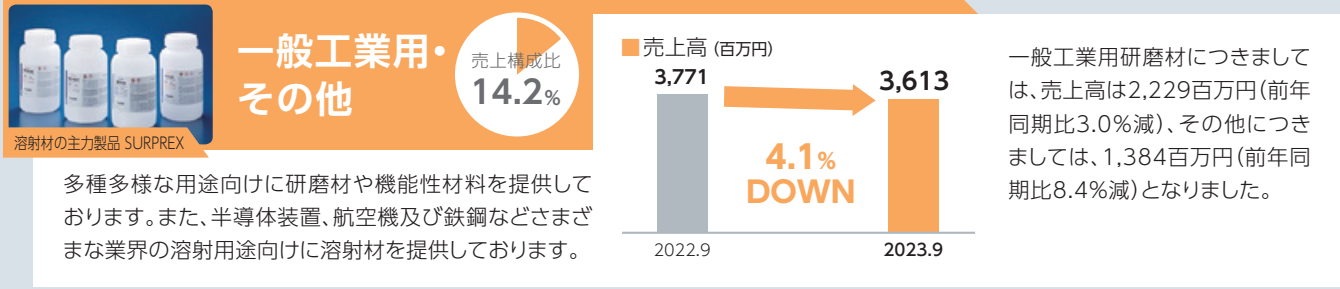
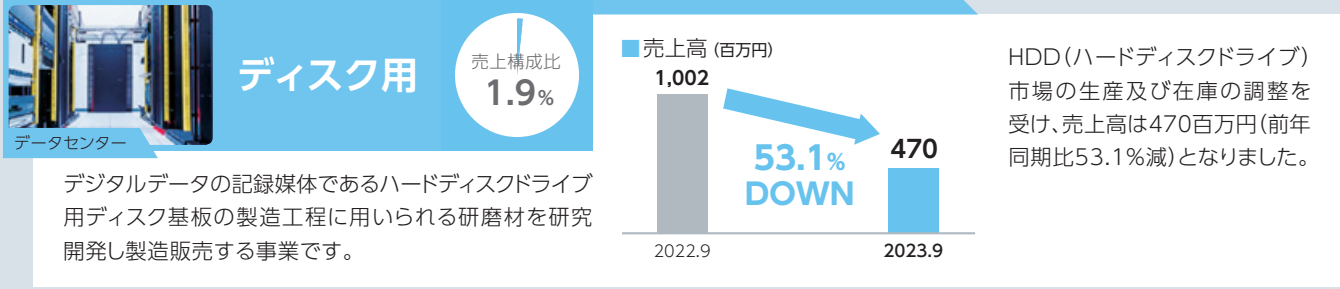
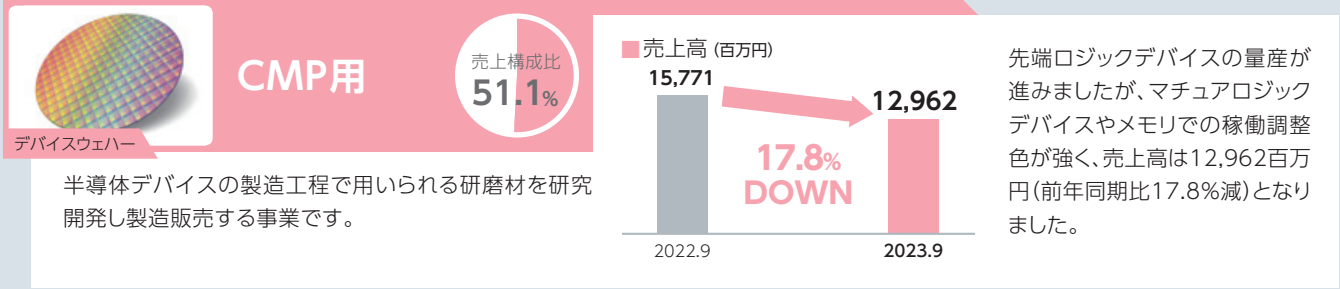
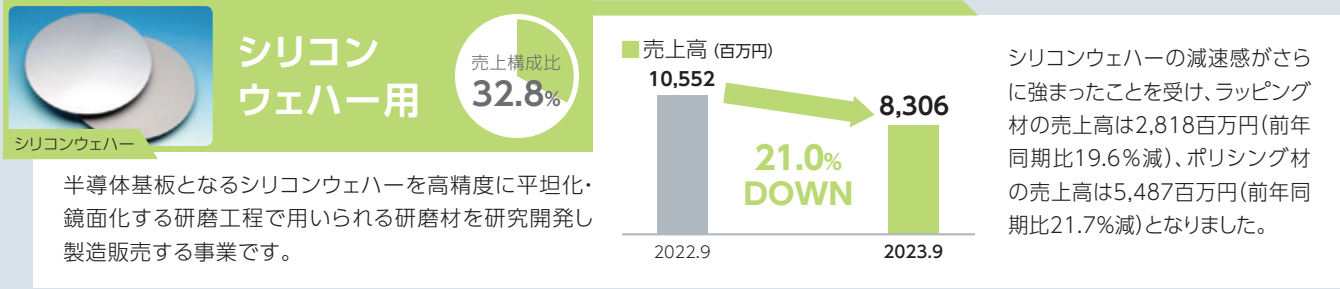
●非半導体関連のサーフェス（表面）分野

自動車塗膜用の研磨材
受託加工ソリューション*

※お客様が抱える研磨加工の課題を当社の研磨技術・知見・ネットワークを活かして、テスト試作から量産ステージ、加工・納品までサポートし、課題解決に取り組めます。

PICK UP 自動車塗膜用の研磨材

自動車塗膜用の研磨材「MIRAFLEXシリーズ」を2021年より上市しております。MIRAFLEXは、硬質・軟質を問わずあらゆる自動車塗膜に対応でき、従来品に比べて研磨時間の短縮かつ仕上がりと作業性が向上するなどの特徴があり、一部大手カーコーティングのお客様に採用されております。引き続き、本製品の拡販を推進してまいります。



新型コロナウイルス感染症対策として、これまで見送っていましたが、対面式の展示会・セミナーへの出展及び参加を再開しました。

「ICPT2023」にゴールドスポンサーとして協賛

ICPT(International Conference on Planarization/CMP Technologyの略)は、世界最先端を走る各国のCMP技術者・研究者が集結し、CMP技術に関する課題や将来の方向性など、意見交換や協力を促進することを目的に開催されるCMPの国際会議です。

2023年10月31日(火)～11月2日(木)の3日間、第18回「ICPT2023」が石川県金沢市の金沢東急ホテルにて開催されました。

当社はゴールドスポンサーとして協賛するとともに、研磨ソリューション本部長の森永が当社のCMPスラリー開発とイノベーションの歴史に関して講演しました。

高機能素材Weekセラミックスジャパンに出展

当社は、2023年10月4日(水)～6日(金)の3日間、千葉県の幕張メッセにて開催された高機能素材Week内のセラミックスジャパンに出展しました。

高機能素材Weekとは、機能性フィルム・プラスチック・セルロース・炭素繊維複合材・金属・セラミックスなどの最先端の素材技術が一堂に出展される世界最大規模の展示会です。

展示ブースでは、高白色板状リン酸チタン粒子、超微粒や球状などの特徴を持つα-SiC粉末、セラミックス溶射材料、積層造形用(3Dプリンター用)超硬粉末などを紹介しました。



名証IRエキスポ2023に出展

当社は、2023年9月8日(金)、9日(土)の2日間、愛知県名古屋市の吹上ホールにて開催された名証IRエキスポ2023に出展しました。



会期期間中は、会社の概要や強み、2023年5月発表の中長期経営計画などに関して説明しました。多くの株主、個人投資家の皆様に当社ブースへお越しいただきました。

石徹白での活動紹介ビデオ5作目を制作

2023年10月に石徹白での活動紹介ビデオ5作目を当社ホームページに掲載しました。

5作目は、岐阜県郡上市石徹白地区にある高畑山で始動した森づくりの様子を中心に活動を紹介しております。ぜひ、ご覧ください。



過去の作品をはじめ、こちらからご覧いただけます。

FUJIMI INCORPORATED広報チャンネル

<https://www.youtube.com/@fujimiincorporated5384>

女性活躍推進企業認定「えるぼし」の最高位3つ星を取得

当社は女性活躍推進に関する取り組みが優良な企業として、厚生労働省より「えるぼし」の最高位である3段階目(3つ星)に認定されました。認定には、「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの評価項目があり、全ての評価項目において基準を満たし、3つ星と認定されました。



「JPX日経インデックス400」構成銘柄に選定

当社は、株式会社JPX総研及び株式会社日本経済新聞社が算出・公表している2023年度(2023年8月31日～2024年8月29日)「JPX日経インデックス400」(以下、JPX日経400)の構成銘柄に選定されました。

JPX日経400は、資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成され、日本企業の魅力を内外にアピールするとともに、その持続的な企業価値向上を促し、株式市場の活性化を図ることを目的に開発された株価指数です。

当社は、今後もステークホルダーの皆様のご期待に沿えるよう、さらなる企業価値の向上に努めてまいります。

「JPX日経400」の詳細につきましては、以下をご参照ください

<https://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/>

野村IR資産運用フェア2024出展のお知らせ

当社は、2024年1月10日(水)～1月25日(木)(うちLIVE配信期間は1月10日(水)～1月13日(土)の4日間)、オンライン上で開催される野村IR資産運用フェア2024に出展します。

また、オンラインイベントに加え、2023年12月に開催される本フェアの対面型イベント野村IR資産運用フェア2024プレリアルにも参加します。

この機会に当社へのご理解を深めていただけますと幸いです。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

野村IR資産運用フェア2024の詳細はこちら

<https://fair.nomura-ir.co.jp/>

野村IR資産運用フェア2024プレリアル

当社説明枠:2023年12月15日(金)14:20～14:50

会場:東京ミッドタウン八重洲カンファレンス(大会議室)

INFOMATION



当社は、株主様のご意見・ご意思を伺う機会として株主総会における議決権行使と株主様のアンケート回答を大切にしております。

株主総会における議決権は、株主様にとって当社の経営にご参加いただき、議案への賛成・反対の意思表示ができる権利であると同時に、当社にとっては、株主様の意思表示を伺うことができる大切な機会

です。議決権を行使していただいた株主様にはお礼としてQUOカードをお送りしております。

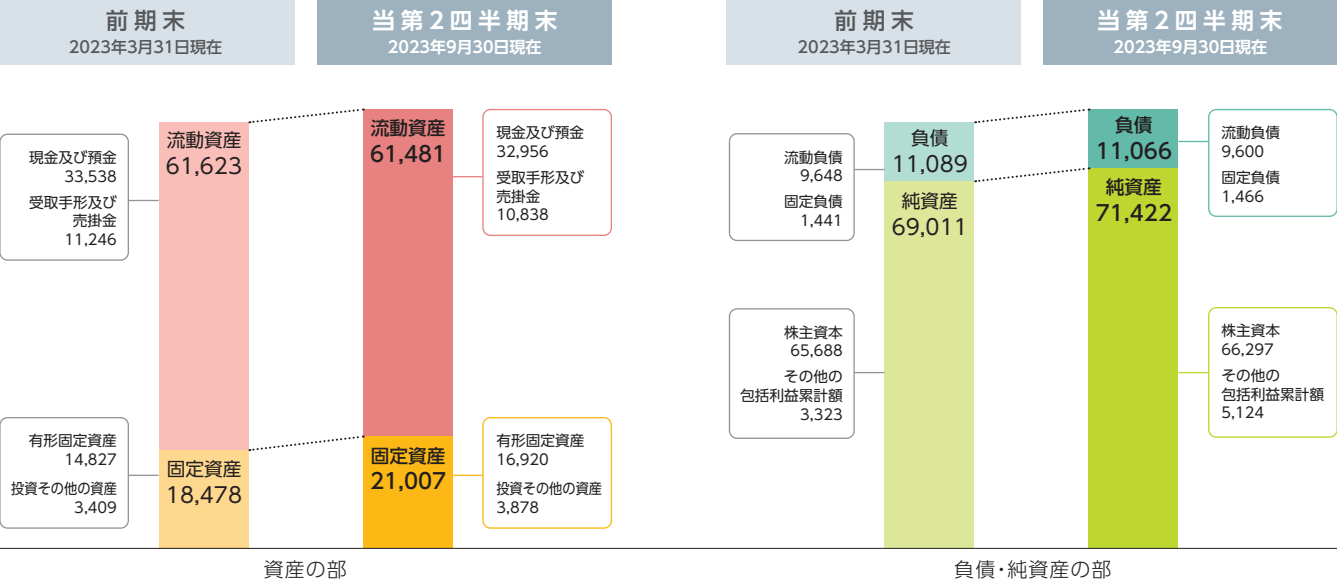
また、株主様との双方向のコミュニケーションを図ることを目的に、株主通信(年2回)に同梱してアンケートハガキをお送りしております。受付期間内にアンケートにご回答いただいた方には、お礼にノベルティをお送りしております。

ノベルティ紹介(過去5号)

- ボールペン3本セット…56号
- カトラリーセット……55号
- マルチクロス…………54号
- LED付タッチペン……53号
- レザーライクケース…52号

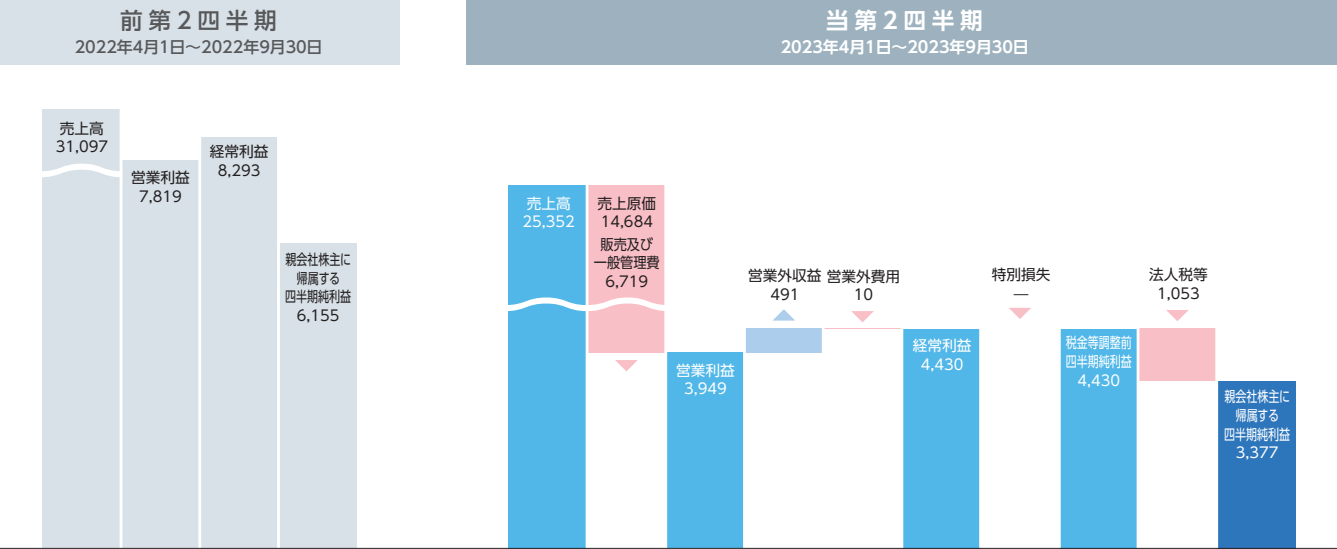
連結貸借対照表の概要

(百万円)



連結損益計算書の概要

(百万円)



解説

総資産

前連結会計年度末に比べ、2,387百万円増加し、82,489百万円となりました。受取手形及び売掛金が408百万円、現金及び預金が582百万円それぞれ減少したものの、その他の有形固定資産が1,813百万円、原材料及び貯蔵品が755百万円、有価証券が500百万円それぞれ増加したことなどによるものです。

負債

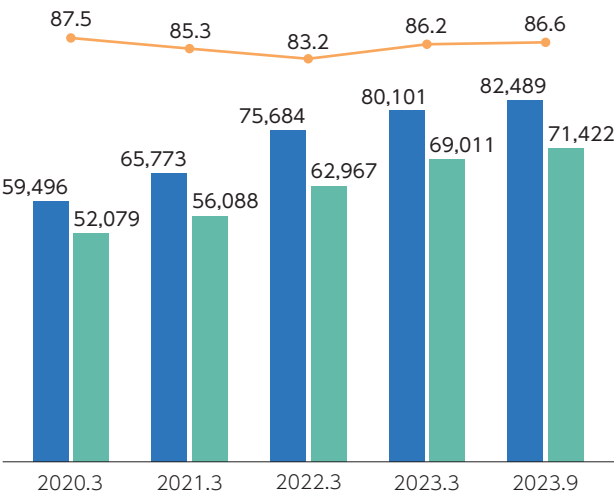
前連結会計年度末に比べ、22百万円減少し、11,066百万円となりました。これは、その他の流動負債が785百万円増加したものの、買掛金が927百万円減少したことなどによるものです。

純資産

前連結会計年度末に比べ、2,410百万円増加し、71,422百万円となりました。これは、利益剰余金が610百万円、為替換算調整勘定が1,517百万円それぞれ増加したことなどによるものです。

総資産・純資産・自己資本比率

(百万円、%)



解説

売上高

PC、スマートフォン及びサーバー市場の低迷に伴い、2022年秋以降の半導体デバイスの生産及び在庫の調整が想定以上に長引いており、シリコンウェハーにおいても減速感が強まっていることから、半導体向け製品の販売が減少し、売上高は前年同期比18.5%減の25,352百万円となりました。

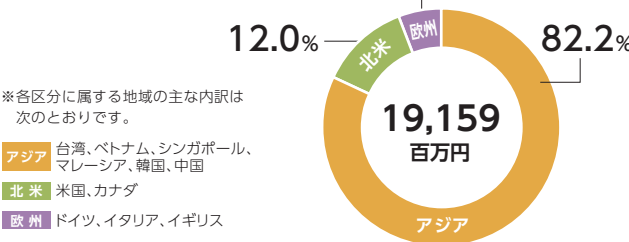
営業利益

半導体向け製品の販売減少と原材料価格などの上昇の影響を受け、前年同期比49.5%減の3,949百万円となりました。

親会社株主に帰属する四半期純利益

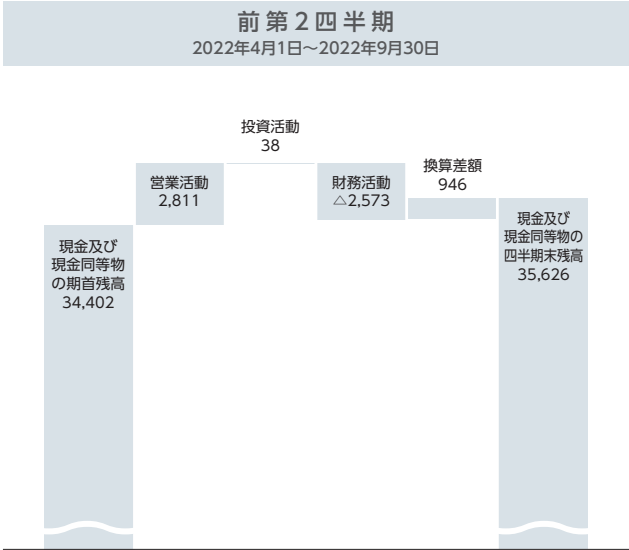
前年同期比45.1%減の3,377百万円となりました。

海外売上高(仕向先別)

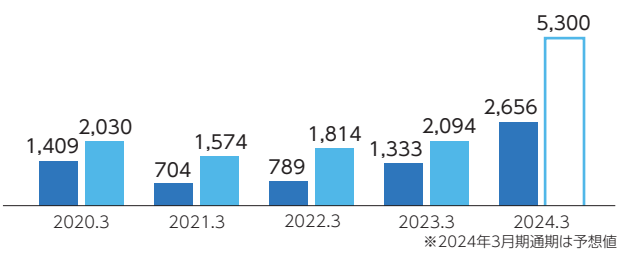


海外売上高	前第2四半期末 2022年4月1日～ 2022年9月30日	当第2四半期末 2023年4月1日～ 2023年9月30日
海外売上高	(百万円) 24,504	19,159
連結売上高	(百万円) 31,097	25,352
連結売上高に占める割合 (%)	78.8	75.6

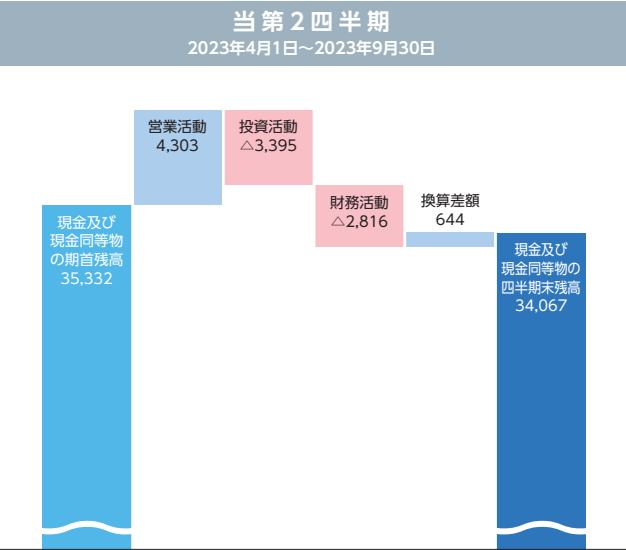
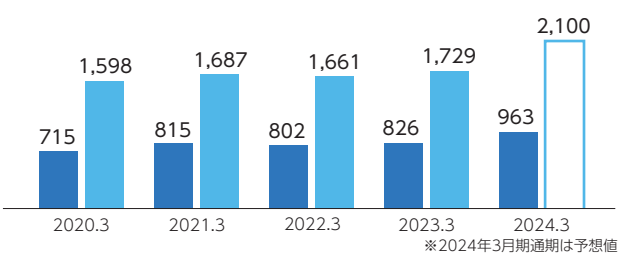
連結キャッシュ・フロー計算書の概要



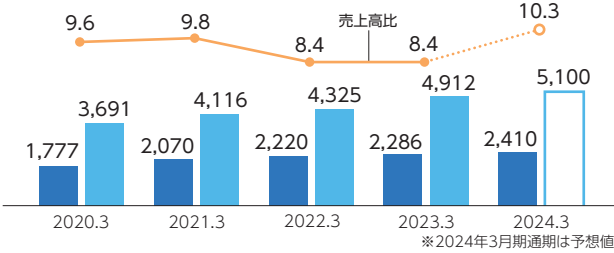
設備投資



減価償却費



研究開発費・売上高比



利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主に対する適正な利益還元を行うことを経営の重要課題と認識し、配当につきましては連結配当性向を55%以上とすることを目標として、業績に応じた積極的な株主還元を実施するとともに安定配当の継続にも留意することを基本方針としております。このような方針のもと、1株につき中間配当を36.67円とし、年間配当は73.34円とする予定です。

株式情報

2023年9月30日現在

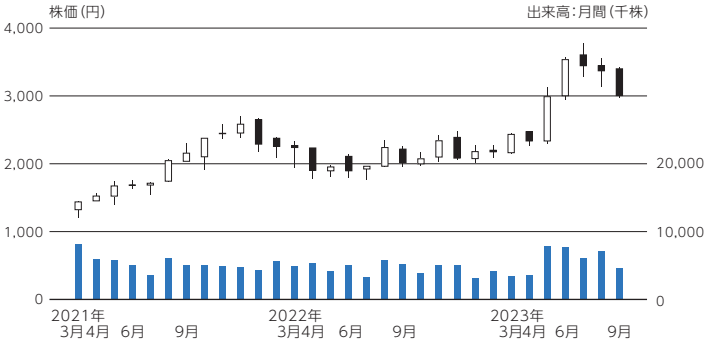
株式の状況

株式数	発行可能株式数	320,000千株
	発行済株式総数	80,098千株
	株主数	8,622名

大株主(株主名)	持株数 (千株)*1	持株比率 (%)*2
有限会社コマ	13,381	17.7
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	7,932	10.5
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	5,430	7.2
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	4,861	6.4
株式会社三菱UFJ銀行	2,185	2.8
日本生命保険相互会社	1,918	2.5
フジミ取引先持株会	1,886	2.5
一般財団法人越山科学技術振興財団	1,800	2.3
第一生命保険株式会社	1,417	1.8
関 敬史	1,323	1.7

*1 持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てています。
*2 持株比率は、自己株式(4,646,121株)を控除して計算しております。

株価及び出来高の推移



株主分布状況

2023年9月30日現在

8,246人 (95.6%)

個人・その他

自己名義株式

4,646千株 5.8%

外国法人等

16,790千株 21.0%

その他の法人

18,102千株 22.6%

376人 (4.4%)

内訳
金融機関 30人 (0.4%)
金融商品取引業者 34人 (0.4%)
その他の法人 88人 (1.0%)
外国法人等 223人 (2.6%)
自己名義株式 1人 (0.0%)

自己名義株式

4,646千株 5.8%

外国法人等

16,790千株 21.0%

その他の法人

18,102千株 22.6%

金融商品取引業者

867千株 1.1%

個人・その他

15,980千株 19.9%

金融機関

23,711千株 29.6%

役員

2023年
9月30日現在

代表取締役社長	関 敬史
常 務 取 締 役	大脇 寿樹
常 務 取 締 役	鈴木 勝弘
取 締 役	川下 政美*
取 締 役	浅井 侯序*
取 締 役	吉村 温子*
常 勤 監 査 役	藤川 佳明
監 査 役	高橋 正彦**
監 査 役	岡野 勝**

*印は社外取締役 **印は社外監査役

会社データ

2023年9月30日現在

商 号	株式会社フジミインコーポレーテッド
証 券 コ ー ド	5384
本 社 所 在 地	愛知県清須市西枇杷島町地領2-1-1 TEL. 052-503-8181(代表)
設 立 年 月 日	1953年(昭和28年)3月20日
資 本 金	4,753百万円
代 表 者	代表取締役社長 関 敬史
従 業 員	1,099名(単体779名)